

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】令和 6 年 3 月 22 日(2024.3.22)

【公開番号】特開 2022-147498(P2022-147498A)
【公開日】令和 4 年 10 月 6 日(2022.10.6)
【年通号数】公開公報(特許)2022-184
【出願番号】特願 2021-48760(P2021-48760)
【国際特許分類】

H 0 5 K 7/20(2006.01)

10

H 0 5 K 5/02(2006.01)

【F I】

H 0 5 K 7/20 A

H 0 5 K 7/20 E

H 0 5 K 5/02 E

【手続補正書】

【提出日】令和 6 年 3 月 13 日(2024.3.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

20

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

駆動により熱を発する電子機器を収容する本体部と、
前記本体部の背面側に設けられ、レール部材に接続される背面部材と
を備え、
前記背面部材は、前記本体部の内部に設置される前記電子機器の表面と対向して直接的
または間接的に接触するように、前記本体部の内部に延伸して構成された接触面部を備え
、
前記背面部材は、前記電子機器を設置するための部材よりも高熱伝導率の材料により構成
される、
電子機器用筐体。

【請求項 2】

前記背面部材は、金属により構成される、
請求項 1 に記載の電子機器用筐体。

【請求項 3】

前記背面部材は、フィンの形状を有する、
請求項 1 に記載の電子機器用筐体。

40

【請求項 4】

前記接触面部は、前記電子機器の表面全体を覆うように構成される、
請求項 1 に記載の電子機器用筐体。

【請求項 5】

前記接触面部は、前記電子機器の表面と直交する方向の厚みが所定値よりも大きくなる
ように構成される、
請求項 1 に記載の電子機器用筐体。

【請求項 6】

前記接触面部は、体積が所定値よりも大きくなるように構成される、
請求項 1 に記載の電子機器用筐体。

50

【請求項 7】

前記背面部材は、前記レール部材と接触する爪部を更に備える、
請求項 1 に記載の電子機器用筐体。

【請求項 8】

前記背面部材は、前記レール部材の凹部の底面と接触する接触部を更に備える、
請求項 1 ～ 7 のいずれか一項に記載の電子機器用筐体。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0059

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0059】

以上、図面を参照しながら各種の実施形態について説明したが、本開示は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例、修正例、置換例、付加例、削除例、均等例に相当し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。また、発明の趣旨を逸脱しない範囲において、上述した各種の実施形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。

(付記)以上の実施の形態の記載により、下記の技術が開示される。(技術 1)駆動により熱を発する電子機器を収容する本体部と、前記本体部の背面側に設けられ、レール部材に接続される背面部材とを備え、前記背面部材は、前記本体部の内部に設置される前記電子機器の表面と対向して直接的または間接的に接触するように、前記本体部の内部に延伸して構成された接触面部を備え、前記背面部材は、前記電子機器を設置するための部材よりも高熱伝導率の材料により構成される、電子機器用筐体。(技術 2)前記背面部材は、金属により構成される、技術 1 に記載の電子機器用筐体。(技術 3)前記背面部材は、フィン形状を有する、技術 1 または技術 2 に記載の電子機器用筐体。(技術 4)前記接触面部は、前記電子機器の表面全体を覆うように構成される、技術 1 から技術 3 のいずれかに記載の電子機器用筐体。(技術 5)前記接触面部は、前記電子機器の表面と直交する方向の厚みが所定値よりも大きくなるように構成される、技術 1 から技術 4 のいずれかに記載の電子機器用筐体。(技術 6)前記接触面部は、体積が所定値よりも大きくなるように構成される、技術 1 から技術 4 のいずれかに記載の電子機器用筐体。(技術 7)前記背面部材は、前記レール部材と接触する爪部を更に備える、技術 1 から技術 6 のいずれかに記載の電子機器用筐体。(技術 8)前記背面部材は、前記レール部材の凹部の底面と接触する接触部を更に備える、

10

20

30

40

50

技術 1 から技術 7 のいずれかに記載の電子機器用筐体。

10

20

30

40

50